



PCB布线注意:
10A的主电流通道走线尽可能加粗,考虑做开窗、镀锡处理,这样做可以减小阻抗,防止发热;
电流通道信号I+, I-要走差分线(靠近,等长);
滤波电容尽量靠近芯片电源引脚;
注意高压部分的电气间隙;

SEG13	33	COM4	1	COM3
SEG14	32	COM3	2	COM2
SEG15	31	COM2	3	COM1
SEG16	30	COM1	4	COM0
SEG17	29		5a	SEG4
SEG18	28		5f	SEG5
SEG19	27		6a	SEG6
SEG20	26		6f	SEG7
SEG21	25		7a	SEG8
	24		7f	SEG9
	23		8a	SEG10
	22		8f	SEG11
	21		9a	SEG12
	20		9f	SEG13
	19		10a	SEG14
			10f	SEG15
			11a	SEG16
			11f	SEG17
			12a	SEG18
			12f	SEG19
			13a	SEG20
			13f	SEG21
			14a	SEG22
			14f	SEG23

	1	2	3	4	5	6	7	8								
A	<div>----- 2011.3.4 V0.1修改说明: ----- 1、原理图 修改k/f/p等符号大小写，增加X2电容耐压，修改版本号与日期，104改为0.1uF； 2、PCB 修改X2电容封装、取样电阻封装、插件LED灯等； ----- 2011.4.22 V0.2修改说明: ----- 1、D3 LED灯改做5V电源指示； 2、P17口只做校准口，加跳帽和电阻并联； 3、P14 加光耦隔离做UART通讯且复用做ENTER按键（总共有4个按键）； 4、P15 加光耦隔离做UART通讯且复用做SET按键； 5、P16 加光耦隔离做IO口通讯且复用做UP按键； 6、P10口只做红外接收头； 7、LCD处接口处做一LED转换板，LCD21脚做LED电源5V线（LCD显示时0R电阻不焊，LED显示时焊） 8、C17/R10位置放在正面（与按键同面），方便焊接； 9、取样电阻处焊锡层需要加粗； 10、增加电池供电及切换电路； 11、增加程序下载口； 12、增加seg22/23与液晶相连； 13、F1、F2增加两个过孔； ----- 2011.7.25 V0.3修改说明: ----- 1、N_IN焊盘大小做了修改； 2、C6/9/11/12封装改为1206-CAP； 3、调整UART接口和外面接头顺序； 4、增加+5.7v电源串10k电阻到P16； 5、调整PCB里S1 S2按键的位置； 6、修改Q1由MOS管改为三极管； ----- 2013.4.11 V0.4修改说明: ----- 1、复位电容改为0.1uF； 2、将UP键与ENTER 键互换了下位置； 3、将光耦817C改为贴片的封装； 4、删除插件的锰铜电阻； 5、将LM78L05的第二引脚直接接地，原来的+5.7V网络改为+5V网络，+5V网络改为+5V_S网络； 6、电容CBB2上并2个470k电阻； -----</div>								A							
B									B							
C									C							
D									D							
	1	2	3	4	5	6	7	8								
								<table><tr><td>绘制: ZDS</td><td>名称: SD3004_DEMO 修改说明</td></tr><tr><td>审核: XJB</td><td>编号: QD06IC08040012010</td></tr><tr><td>批准: WL</td><td>日期: 2011.7.25 页数: 2/2</td></tr><tr><td colspan="2">杭州晶华微电子有限公司 Hangzhou SDIC Microelectronics Co., Ltd.</td></tr></table>	绘制: ZDS	名称: SD3004_DEMO 修改说明	审核: XJB	编号: QD06IC08040012010	批准: WL	日期: 2011.7.25 页数: 2/2	杭州晶华微电子有限公司 Hangzhou SDIC Microelectronics Co., Ltd.	
绘制: ZDS	名称: SD3004_DEMO 修改说明															
审核: XJB	编号: QD06IC08040012010															
批准: WL	日期: 2011.7.25 页数: 2/2															
杭州晶华微电子有限公司 Hangzhou SDIC Microelectronics Co., Ltd.																

绘制: ZDS	名称: SD3004_DEMO 修改说明	
审核: XJB	编号: QD06fC08040012010	
批准: WL	日期: 2011.7.25	页数: 2/2
杭州晶华微电子有限公司 Hangzhou SDIC Microelectronics Co., Ltd.		